

R.O.C Patent No. 560,697

Title: Structure of SMD LED

Summary:

The utility discloses the structure of surface mounted diode LED which
5 comprises a printed circuit board (PCB) and there is a metal reflective cup set on the
PCB, and then at least one LED chip mounted on the surface of cup to result in
forming a electrically connection between the LED chip and the PCB. Wherein the
LED chip is enveloped with packaging glue above the PCB as the required pattern,
furthermore, the packaging glue is casted on the PCB unitized. Thus, the packaging
10 glue will not fall off anyway, and then the device can reflect the light adequately.

公告本

91.12.13

申請日期：91.11.26
申請案號：91219020

IPC分類 H01L 23/31

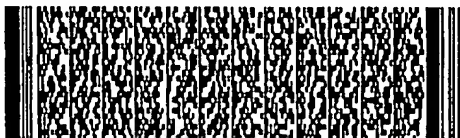
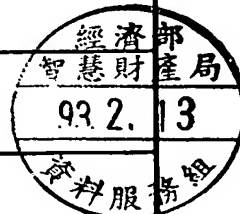
(以上各欄由本局填註)

新型專利說明書

560697

一、 新型名稱	中文	表面黏著型發光二極體之結構	
	英文		
二、 創作人 (共1人)	姓名 (中文)	1. 林榮淦	
	姓名 (英文)	1.	
	國籍 (中英文)	1. 中華民國 TW	
	住居所 (中文)	1. 桃園縣龜山鄉嶺頂村振興路56號	
	住居所 (英文)	1.	
三、 申請人 (共1人)	名稱或姓名 (中文)	1. 玄基光電半導體股份有限公司	
	名稱或姓名 (英文)	1.	
	國籍 (中英文)	1. 中華民國 TW	
	住居所 (營業所) (中文)	1. 桃園縣龜山鄉嶺頂村振興路56號 (本地址與前向貴局申請者相同)	
	住居所 (營業所) (英文)	1.	
	代表人 (中文)	1. 黃恆俊	
	代表人 (英文)	1.	

智慧局資料中心所提供之資料，僅供參考，如要作為判斷，仍請洽本局權責單位確認各項資料相關狀態。



以青委頁明示，本案修正後是不變更原實質內容。